

300mm全自动芯片背面保护胶带贴合机

RAD-3600F/12



概述

本全自动贴合机用于在研磨后的晶圆背面贴合晶片背面保护胶带“Adwill LC胶带”。

可进行晶圆校准、Adwill LC胶带预切割、胶带贴合、离型膜撕除。

- 选配功能**
- 主机通信功能
(通信方式: SECS-I、HSMS标准; 软件: GEM标准)
 - 双晶盒供料
 - 晶圆ID读取器

适用的胶带 • 晶片背面保护胶带 “Adwill LC胶带”

规格

额定电源	供电电压	: AC200-230V ±10% (AC190-253V)
	频率	: 50/60Hz
	位相	: 单相
气源	功耗	: 6.0kW
	供气压力	: 0.5-0.8MPa
	耗气量	: >150L/分钟 (ANR)
真空供给	真空压力	: >-80kPa

适用的晶圆尺寸

200mm, 300mm

尺寸

机台宽度(W) : 1,550mm
设备纵深(D) : 1,950mm
设备高度(H): 1,800mm
(凸出物及三色警示灯除外)

重量

1,500kg

UPH

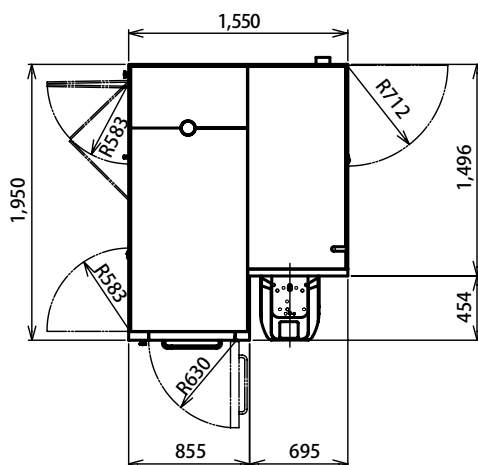
30片/小时 (安装时间除外)

上述处理能力的依据条件如下。

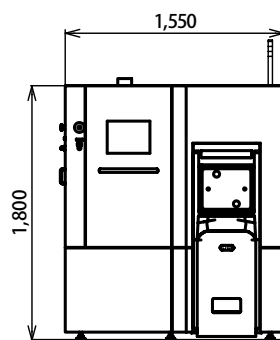
晶圆 : 未研磨300mm镜面晶圆

晶片背面保护胶带 : LC2850(40) from LINTEC

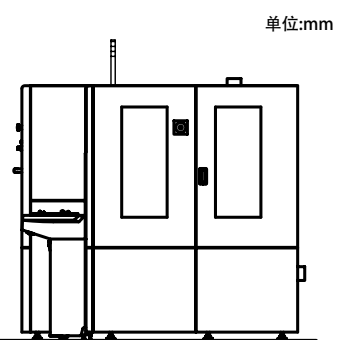
设备外形图



平面图



正面图



右侧面图

单位:mm